



# 兆舜科技（广东）有限公司

## 产品说明书（TDS）

### ZS-GF-5299Z

#### 一、产品特点及应用

ZS-GF-5299Z 是一种低粘度双组分加成型有机硅高导热灌封胶，可以室温固化，也加热固化，具有温度越高固化越快的特点。本品在固化反应中不产生任何副产物，可以应用于 PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC 等材料及金属类的表面，可在-40℃至 200℃环境下使用。完全符合欧盟 ROHS 指令要求。

#### 二、典型用途

电源模块的灌封散热保护

其他电子元器件的灌封散热保护

#### 三、技术参数

性能指标		A 组分	B 组分	检验标准
固 化 前	外观	浅红色流体	灰白色流体	目测
	粘度 (cps)	3000~5000	3000~5000	GB/T 10247-2008
	混合比例 A:B (重量比)	1 : 1		Q/ZS 1-2016
	混合后粘度 (cps)	3000~5000		GB/T 10247-2008
	25℃适用时间 (min)	60-90		GB/T 7123
	25℃成型时间 (h)	4-6		GB/T 531
固 化 后	硬度(shore A)	30-40		GB/T 531.2
	导热系数 [W/m·K]	≥2.0		ASTM D5470
	介电强度 (kV/mm)	≥13		GB/T 1695
	介电常数 (1.0MHz)	2.8-3.3		GB/T 1693
	体积电阻率 (Ω·cm)	≥1.0×10 <sup>13</sup>		GB/T 1692
	比重	2.85±0.05		Q/ZS 1-2016

以上固化前性能数据均在当日生产产品室温条件下所测，机械性能及电性能数据均在试样完全固化后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。



# 兆舜科技（广东）有限公司

## 产品说明书（TDS）

### 四、使用工艺

- 1、混合前：首先把 A 组分和 B 组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
- 2、混合时：应遵守 A 组分：B 组分=1：1 的重量比，并搅拌均匀。
- 3、排泡：胶料混合后应真空排泡 1-3 分钟。
- 4、灌封：混合好的胶料应尽快灌注到被灌产品中，以免后期胶料增稠而流动性不好
- 5、固化：室温加温固化均可，温度越高，固化速度越快。

### 五、注意事项

- 1、胶料应在干燥室温环境下密封贮存，混合好的胶料应尽快用完，避免造成浪费。
- 2、本品属非危险品，但勿入口和眼。
- 3、本品无毒，具有良好的生理惰性，对皮肤无刺激和伤害。产品不含有易燃易爆成份，不会引发火灾及爆炸事故，对运输无特殊要求。
- 4、存放一段时间后，胶会有所分层。请搅拌均匀后使用，不影响性能。
- 5、以下物质可能会阻碍本产品的固化，或发生不固化现象，所以，最好在进行简易实验验证后应用，必要时需要清洗应用部位。
  - a、不完全固化的缩合型硅酮胶。
  - b、胺固化型环氧树脂。
  - c、白蜡焊接处或松香焊点。

### 六、包装规格及贮存及运输

- 1、A 剂 10kg/桶、20kg/桶；B 剂 10kg/桶、20kg/桶。
- 2、本产品的贮存期为 1 年（25℃以下），超过保存期限的产品应确认无异常后方可使用。
- 3、此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

### 七、建议和声明

建议用户在正式使用本产品之前先做适用性试验。由于实际应用的多样性，我公司不担保特定条件下使用我司产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失的责任，用户在使用过程遇到什么问题，可联系我公司售后服务部，我们将竭力为您提供帮助。